

证券代码：688183

证券简称：生益电子

生益电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称或人员姓名	泰康基金、汇添富基金、建信基金、财通基金、中金资管、华泰证券资管、复星高科、中新融创等90余名投资者 本次投资者关系活动采取线上会议形式，线上参会者无法签署调研承诺函。在交流活动中，我司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
时间	2026年6月23日
地点	线上会议
上市公司接待人员	董事会秘书：林江 财务总监：黄乾初
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司基本情况</p> <p>董事会秘书简要介绍公司基本情况，包括公司基本经营情况、主要产品应用领域、主要财务情况等内容。</p> <p>二、互动交流的主要问题</p> <p>1、公司产品结构和毛利率情况</p> <p>2025年公司产品主要分为服务器/计算机板、通信网络设备板、汽车电子板以及其他板（包括消费电子、医疗、航空航天等）等，其中服务器/计算机板收入占比为67.01%，通信网络设备板占比为21.31%，汽车电子板以及其他板收入占比为11.68%。2025年公司综合毛利率为31.16%。</p> <p>2、公司本次募投项目情况和进度</p> <p>东莞人工智能计算HDI生产基地建设项目属于公司现有产品的升级迭代和产能扩张，该项目主要生产5阶及以上高阶HDI板，产品进一步升级迭代，达产后年产能将达到16.72万平方米。项目目前已完成了土建招标并在2026年5月末正式开工建设，项目计划2028年试生产。</p> <p>吉安智能制造高多层算力电路板项目计划年产能70万平方米，规划产品以平均16层的高多层板为主，项目实施地点为现有厂房的四层、五层全</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>部区域和一层已分隔的独立区域，目前公司已使用自有资金进行前期的建设，正在进行第一阶段的设备采购及安装调试，计划2026年6月末开始试生产。</p> <p>3、公司泰国项目、智能算力中心高多层高密互连电路板项目进展情况</p> <p>公司于2023年7月正式启动泰国生产基地建设项目，项目于2025年3月正式获得泰国投资促进委员会（BOI）颁发的投资优惠证书，2025年末，公司已完成厂房主体建筑封顶，并全面展开公共设施的安裝与机电配套工程，计划于2026年下半年进行试生产。</p> <p>公司东莞制造基地现有厂房投资智能算力中心高多层高密互连电路板项目，于2024年12月正式启动，2025年项目一期已试生产，产出产值已达到预期目标，2026年正式投产并进入产能爬坡期；项目二期2026年第二季度投入使用。2026年公司将全力推进提产扩产事宜，以保证快速满足智能算力领域产能需求。</p> <p>4、公司对未来PCB市场规模以及行业发展前景的预期</p> <p>PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业，也是电子信息技术产业的核心基础组件。根据Prismark数据，2030年全球PCB产值将增长至1,233.48亿美元，2025年至2030年全球PCB产值的预计年复合增长率达7.7%。其中，服务器/数据存储和通信网络是增速最快的细分市场，且服务器/数据存储已经超越消费电子成为PCB下游第一大应用领域。</p> <p>其中受益于全球AI基础设施（包含服务器设备、存储设备、AI加速卡等）市场规模正快速扩张，由此带动的AI服务器等高算力设备出货量迅速提高。根据Prismark数据，预计2029年全球服务器/数据存储领域PCB产值规模将达到225.46亿美元，2024年-2029年将以15.6%的复合增长领跑PCB其他应用领域。</p> <p>AI数据中心的快速扩张亦相应带动高端交换机和高速光模块等高速网络基础设施的需求增长，根据Prismark数据，预计到2029年，全球通信设备领域PCB产值将达到151.55亿美元，2024-2029年将保持平均每年10.2%的复合增长。</p> <p>未来公司对PCB行业的发展保持信心，将通过深耕服务器和通信网络等市场，紧抓本轮行业高景气机遇。</p> <p>5、目前原材料价格增长及原材料供应紧张对公司业绩的影响</p> <p>2025年第4季度起，受铜价等外部因素以及上游供应商产能受限等影</p>
----------------------	---

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>响，原材料价格出现上涨，本轮原材料涨价属于行业共同面对的现状，原材料的涨价将带动产业链各个环节价值传导。同时公司通过持续强化内控管理，进一步优化产品结构及提升质量管理水平，促进了公司业绩增长。2026年第一季度，公司毛利率及净利润均实现同比增长。</p> <p>后续公司将持续关注主要原材料以及大宗商品等的价格走势，及时分析市场供需变化，并根据订单情况、库存情况以及原材料和大宗商品价格波动预测，动态调整公司的供应策略，将原材料价格增长对公司业绩影响降低。</p> <p>6、公司下游客户开发的情况</p> <p>公司秉承“市场引领，双轮驱动”的发展战略，不断与服务器/计算机、通信网络、汽车电子等下游领域知名客户持续积极接触或建立合作关系。目前公司客户储备丰富，且主要客户均为下游行业的头部企业，已涵盖众多境内外头部AI客户，同时公司也持续推进新客户的认证和开发工作，新客户认证进度良好。</p> <p>7、公司产能及产能利用率情况</p> <p>公司现有产能和产能扩产规划安排上，截至2026年3月，公司现有产能236万平方米/年，在建和拟建产能124.62万平方米/年，在建项目除再融资的两个募投项目以外，公司其他扩产项目主要为2个自有资金在建项目，分别为智能算力中心高多层高密互连电路板项目二期和泰国工厂一期（大算力高端电路板）项目。2025年公司产能利用率为92.97%。</p> <p>8、公司与控股股东生益科技的交易情况</p> <p>生益科技为公司控股股东，也是公司原材料覆铜板的供应商之一。公司一直保持自主管理、独立经营。生益科技作为公司的关联方，双方之间的交易严格遵循市场定价原则，价格结算公平、公允、合理，符合关联交易的相关管理规定，确保符合全体股东的利益。</p> <p>注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年6月24日</p>